

平成 30 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 新光電気工業株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 豊 木 則 行
コード番号 6967 東証第 1 部
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長
清 野 貴 博
TEL (026) 283-1000 (代)

半導体用フリップチップタイプパッケージの生産体制強化に関するお知らせ

当社は、半導体の高機能化・高速化に対応する次世代フリップチップタイプパッケージの生産体制強化をはかるべく、下記のとおり設備投資を実施することを決定いたしました。

フリップチップタイプパッケージは、半導体の微細化、高密度化に対応し、電気特性・耐熱性に優れた半導体パッケージとして、パソコン、サーバーに搭載されるCPU等の高性能半導体向けに数多く使用されてまいりました。

今後、半導体市場は、IoT、人工知能（AI）の活用の進展や、自動運転の実用化に向けた展開等を背景としてさらに拡大し、大容量のデータを高速で処理するサーバー向けをはじめとして、高性能半導体の需要も一層高まることが想定されます。当社は、これらのニーズに対応する次世代フリップチップタイプパッケージの生産体制強化をはかるべく、設備投資を実施することといたしました。



設備導入予定の高丘工場 J 棟

【設備投資の概要（予定）】

- (1) 設備の内容 : 次世代フリップチップタイプパッケージ製造設備
- (2) 投資額 : 215億円（2018～2019年度投資額計）
本設備投資に必要な資金は自己資金等をもって充当する方針です。
- (3) 設置工場 : 高丘工場（長野県中野市）他
- (4) 稼働開始予定 : 2020年度
- (5) 生産能力 : 本設備投資により、フリップチップタイプパッケージの生産能力は、既に着手している設備投資による寄与分を含め、2020年度までに約20%程度増強することを見込んでおります。
なお、今後、さらなる需要拡大が見込まれる場合は、生産能力の一層の増強を検討してまいります。

以上